

株式会社TMH 個人投資家向け会社説明会

福証IRフェスタ2026秋

東証グロース市場 / 福証Q-Board市場：280A
2026年9月12日

AGENDA

1. 事業概要

2. 市場環境

3. 成長戦略

4. 中期経営計画

株主の皆さまへ



代表取締役社長
榎並 大輔

半導体市場は、AIの進化、量子コンピュータ、IoTといった技術革新を牽引役に驚異的な成長を遂げており、あらゆる産業の競争力を左右する戦略的に重要な産業として、その存在感を一段と高めています。

こうした中、世界中の半導体工場が稼働を続け、半導体製造装置の累積台数が増えるほど、当社が属する半導体製造アフターマーケット市場も着実に拡大していくと考えています。

当社は、エンジニアリングとデジタル化（プラットフォーム）の両面から半導体工場のサプライチェーンを支え、工場の安定稼働に貢献してまいりました。私たちは、**日本の半導体産業、ひいては日本のものづくりの復権に貢献するという強い使命感**を持って活動しています。半導体産業が日本の産業競争力を再び世界に示す原動力となるよう、挑戦を続けてまいります。今後とも、当社の挑戦と成長にご期待いただき、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。



株式会社TMHは、Technology Makes Happinessの
頭文字から社名が構成されています。

MISSION

先端技術で豊かな社会を創ること

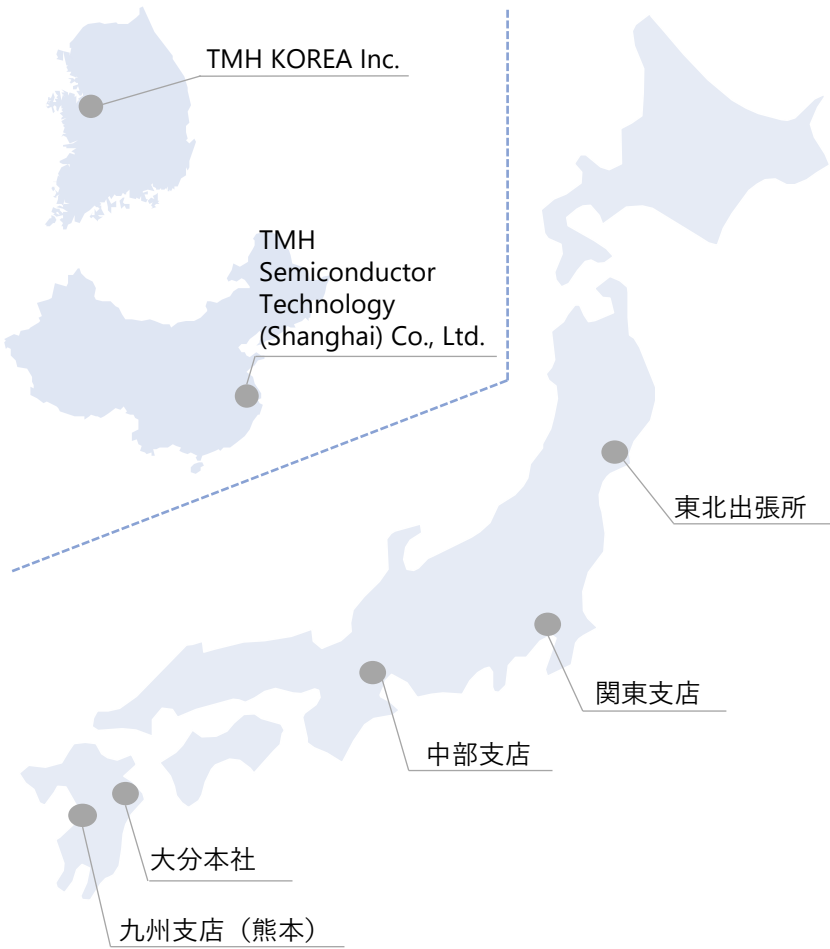
VISION

最高のバリューを提供し続けること

会社概要

会 社 名	株式会社TMH
代 表 取 締 役 社 長	榎並 大輔
所 在 地	大分県大分市下郡北3-14-6
設 立	2012年3月9日
従 業 員 数	49名（2026年 5 月末時点、連結ベース）
資 本 金	3 億1,289万円（2026年 5 月末時点）
事 業 内 容	半導体製造フィールドソリューション事業 （装置・部品の販売・修理、 越境ECサイトLAYLA-ECの運営）
事 業 所	大分本社・中部支店・関東支店 ・東北出張所・九州支店（熊本）
海 外 子 会 社	2 社（韓国 平澤市、中国 上海市）

国内 **5 拠点** + **韓国・中国** に展開



マネジメントチーム

半導体製造装置の専門家が不足するなか、半導体・サプライチェーンの専門家にて構成



榎並大輔 Taisuke Enami
代表取締役
CEO

早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。
東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。
創業以来連続増収を実現。
2020年には大分県から地域牽引企業として選定



香月賢一 Kenichi Katsuki
取締役 CPO

株式会社東芝入社後、20年以上購買・調達に従事。2012年には
東芝本社で半導体部門の材料調達を担当。年間数十億円のコス
トダウンや改善を実現。2016年にTMHに参画



関真希 Maki Seki
取締役 CFO

大手事業会社、デロイトトーマツコンサルティング社にて経営改
革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A等サプライチェ
ーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015年にTMHに参画

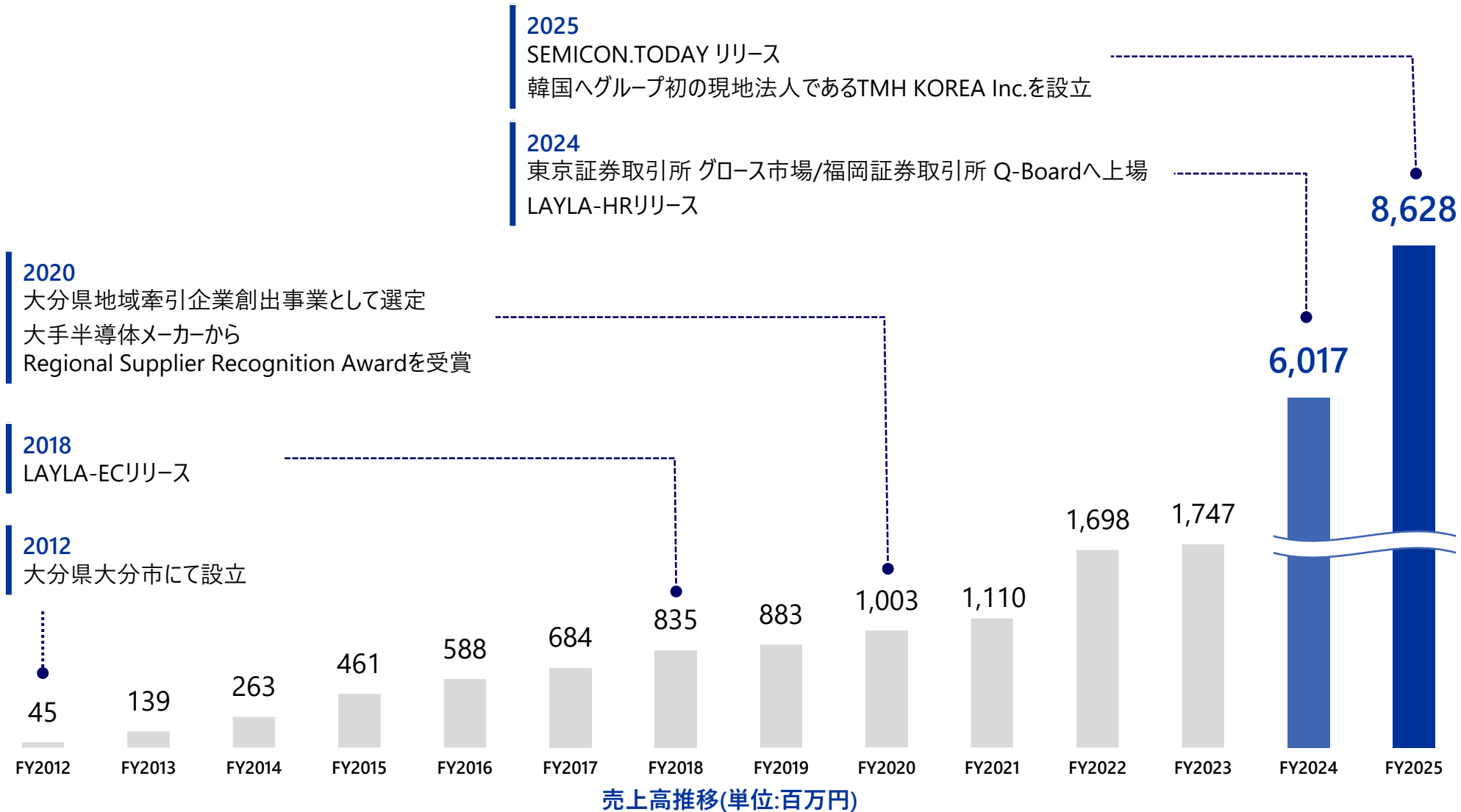


野木村修 Osamu Nogimura
社外取締役

名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。
ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員
生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ
代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事

沿革

LAYLAプラットフォーム、装置販売事業の拡大により設立から継続して成長





半導体業界が直面する様々な社会課題を解決する リーディングカンパニー

領域	提供する価値	特徴
巨大な 半導体業界	半導体製造装置の延命 メンテナンスコストの軽減	ニッチトップ かつ 高成長

当社が必要とされる背景

老朽化した半導体工場には、多様なサプライチェーン課題が山積した状態

調達の課題

- 日本の工場の多くは**陳腐化・老朽化が進み**、**レガシー**半導体製造装置が多く、**部品の調達が困難**
- レガシー半導体製造装置部品の調達は、属人的な調達手法が中心（**デジタル化の遅れ**）

製造の課題

- IoT（Internet of Things）による急速な需要の高まりにより、**旧型装置の需要が継続**
- 長期的な国内半導体市場の低迷により、**エンジニア人材が枯渇**
- レガシー半導体工場では**設備保全の属人化が常態化**、装置トラブルが品質問題や大規模な納期遅延に発展

物流の課題

- 部品取りのために購入した**旧型装置の保管が常態化**することで**生産スペースを圧迫**

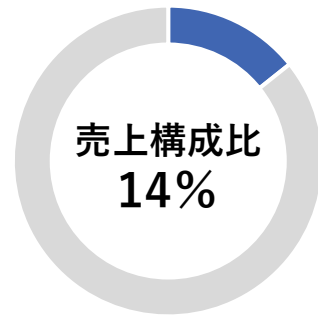
当社が目指す未来

半導体製造に関する多様な課題を解決し、
日本のものづくりの復権を支えます

半導体工場へのトータルソリューションサービスを提供

越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス

世界中の半導体製造装置・部品の売買にプラットフォームを活用

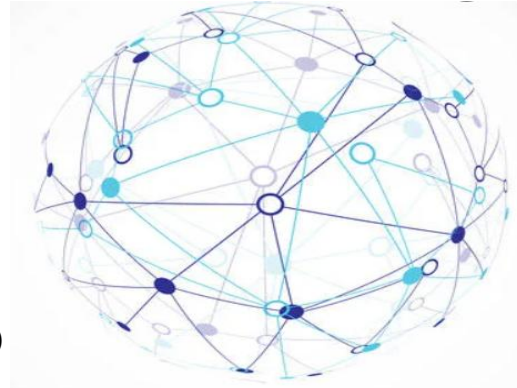


【サービス内容】

- ✓ 希少部品の供給
- ✓ 幅広い修理サービスの提供

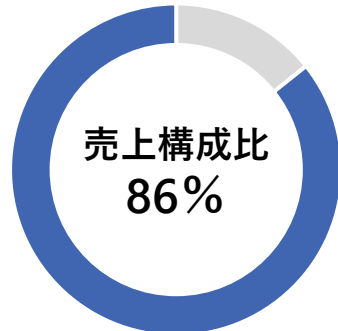
【実績】

- ✓ 200社超の優良なグローバルサプライヤー（多種多様なメンテナンスや部品供給）
- ✓ 39.4万点超のアイテム数、50%超の国内半導体工場が導入済み



エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

装置解体、移設、搬出、プロセスチューニング、立上げサービスを提供



【サービス内容】

- ✓ 専門性が必要な装置の解体から搬出まで一気通貫でのサービス提供
- ✓ 旧型装置のプロセスチューニングによる歩留まりの改善

【実績】

- ✓ 大手米国半導体メーカーからサプライヤーアワード受賞
- ✓ 過去の実績を持つ信頼性（半導体製造装置の取引、100台超）

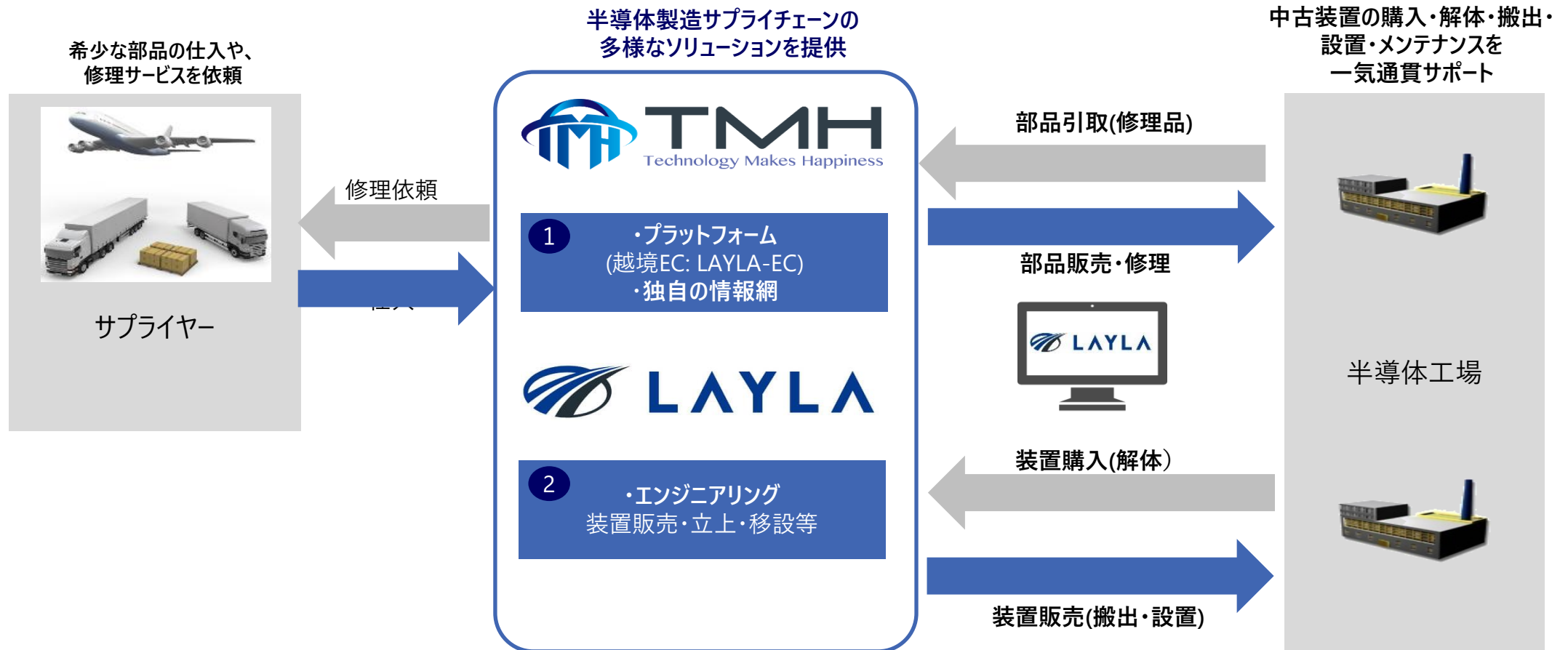


売上構成比は2025年11月期実績

ビジネスフロー

ECプラットフォームとエンジニアリングを融合し、半導体工場の持続的な稼働を支援

- 世界中のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、部品の修理や販売、歩留まりの改善、不要装置・部品の買取など、お客様の課題に対して幅広いソリューションを提供
- LAYLAでは世界中の装置・部品のデータを集積し、半導体製造装置の調達プロセスを効率化
半導体工場における半導体製造装置の効率的な運用と持続可能性に貢献

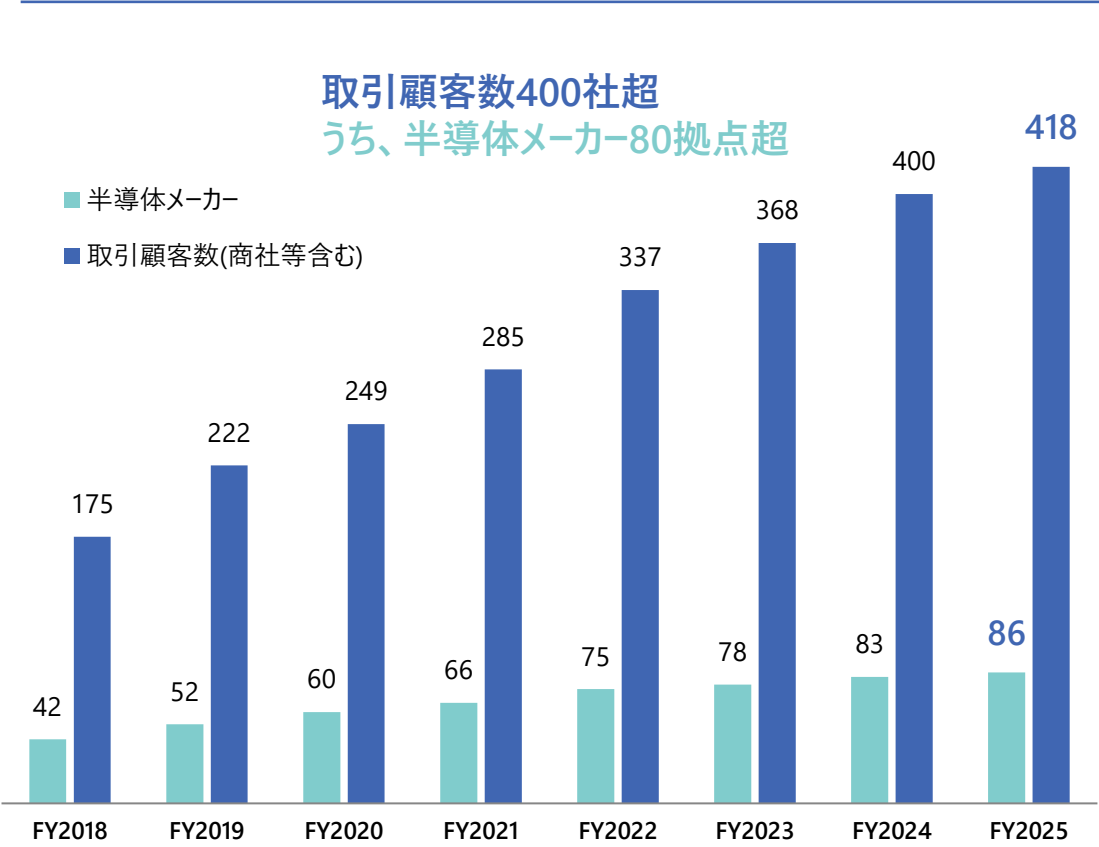


顧客

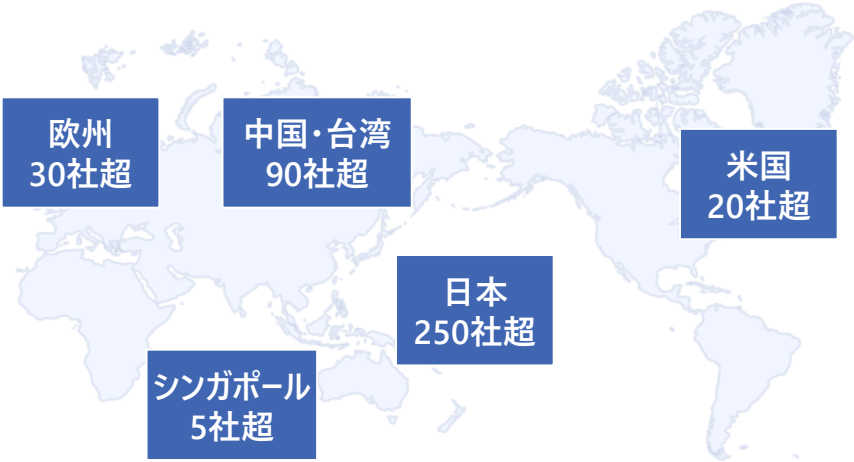
越境ECサイトを活用した圧倒的な調達力により、国内の半導体メーカーとの直接取引を拡大

- 国内ほぼすべての半導体メーカーと直接取引口座を開設済み
- 顧客のうち半導体メーカーは80拠点超。その他顧客も含めて全ての取引顧客数で400社超
- LAYLA-ECの展開により、海外半導体メーカーとの取引も拡大

顧客数推移



国別クライアントマップ



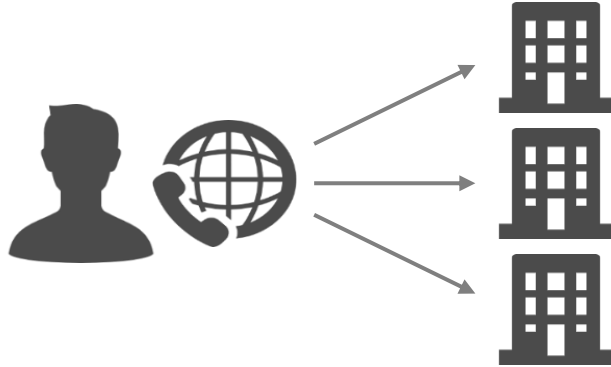
主な取引実績

- ・ キオクシア
- ・ テキサスインスツルメンツ
- ・ ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
- ・ ルネサスエレクトロニクス
- ・ SUMCOグループ
- ・ 東芝グループ
- ・ ラピス 他

LAYLAが提供する価値 世界中の実在庫が可視化できるプラットフォームを確立

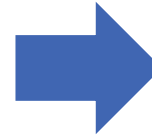
- 従来の調達方法では困難だった実在庫の可視化を実現し、**半導体製造装置の調達活動を効率化できるプラットフォームを提供**

従来の調達方法



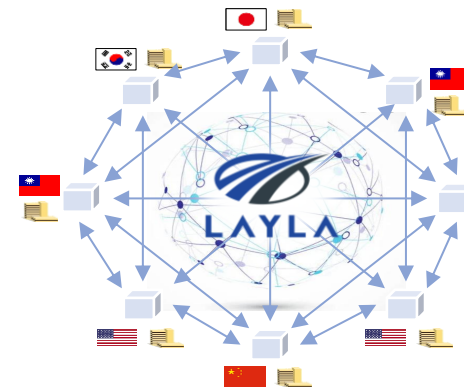
- 調達担当者が、必要な情報を各社に個別で問い合わせなければならないため、**必要な情報が限定される**
- 従来の調達方法では納品まで、**時間、コストがかかりすぎる**
- 調達ルートが限定されてしまうため、**独自に調達ネットワークを確立する必要がある**

老朽化した製造装置の部品調達が困難



LAYLA

商品数**39.4**万点超



世界中の
点在している
部品を集約

- **実在庫を24時間365日確認可能**
- 可視化された実在庫の**価格、納期、保証期間、状態まで確認可能**
- TMHが販売窓口として機能するため、エンドユーザーが安心して購入できる環境を実現(安心保証)

半導体工場のDX化に貢献

ビジネスフロー 装置売買プロセス

装置売買の前提となる解体作業ノウハウが当社にあることが売買加速に

- 装置売買において最も重要となる解体工程を内製化
高度なエンジニアリング力により迅速かつ信頼性の高い取引を実現



AGENDA

1. 事業概要

2. 市場環境

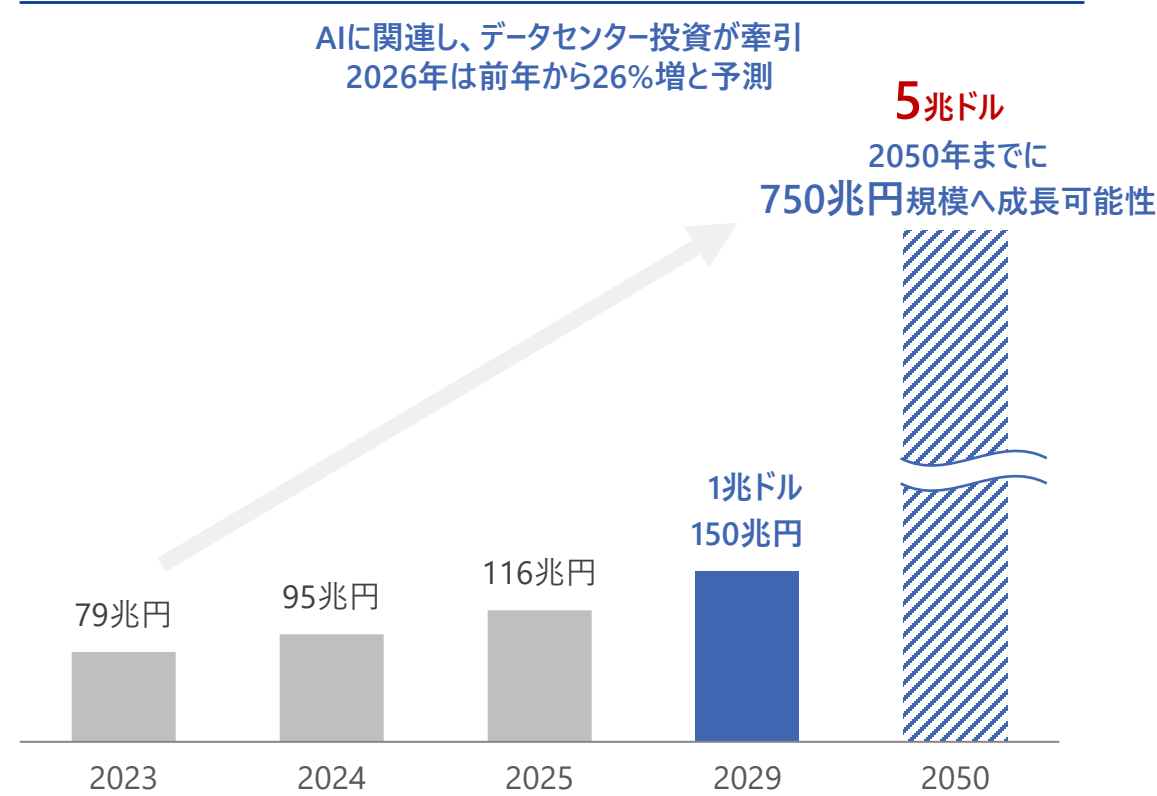
3. 成長戦略

4. 中期経営計画

世界の半導体市場規模
150兆円予測を凌駕する市場ポテンシャルの更なる高まりが、当社の成長戦略を後押し

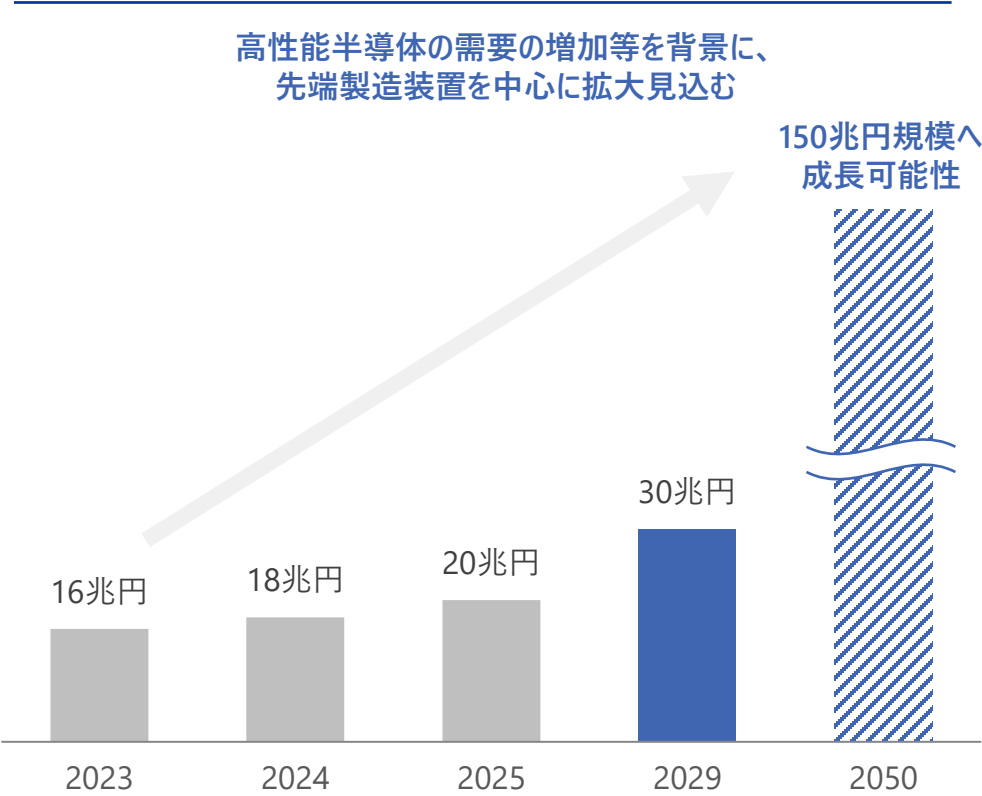
- 世界の半導体市場は、AI需要に関連した投資が牽引し、2029年までに150兆円（1兆ドル）まで急拡大の予想
長期的には、2050年までに750兆円（5兆ドル）まで成長する可能性
- 当社が中長期ターゲット市場と見据える半導体製造装置市場についても順調に拡大

世界の半導体市場予測



出所：(一社)WSTS日本協議会「WSTS 2025年秋季半導体市場予測について」
東京エレクトロン(株) コーポレートサイト「The Future of the Semiconductor Industry and its People」
※150円/USDにて日本円換算後

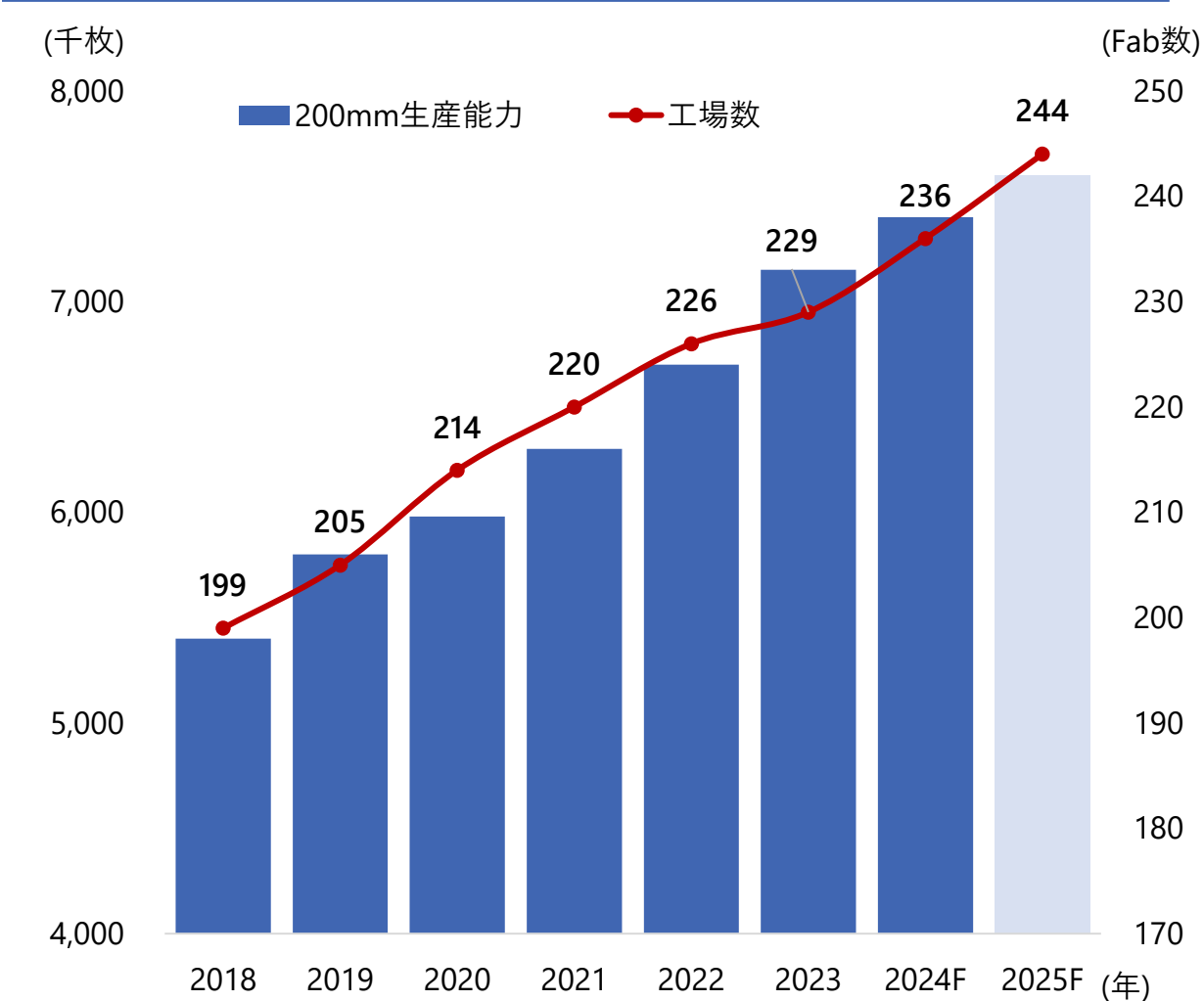
世界の半導体製造装置市場予測



出所：SEMI「世界半導体製造装置の2025年末市場予測発表」を元に試算
2050年は、半導体市場全体の成長率と同水準で推移するものと仮定し算出
※150円/USDにて日本円換算後

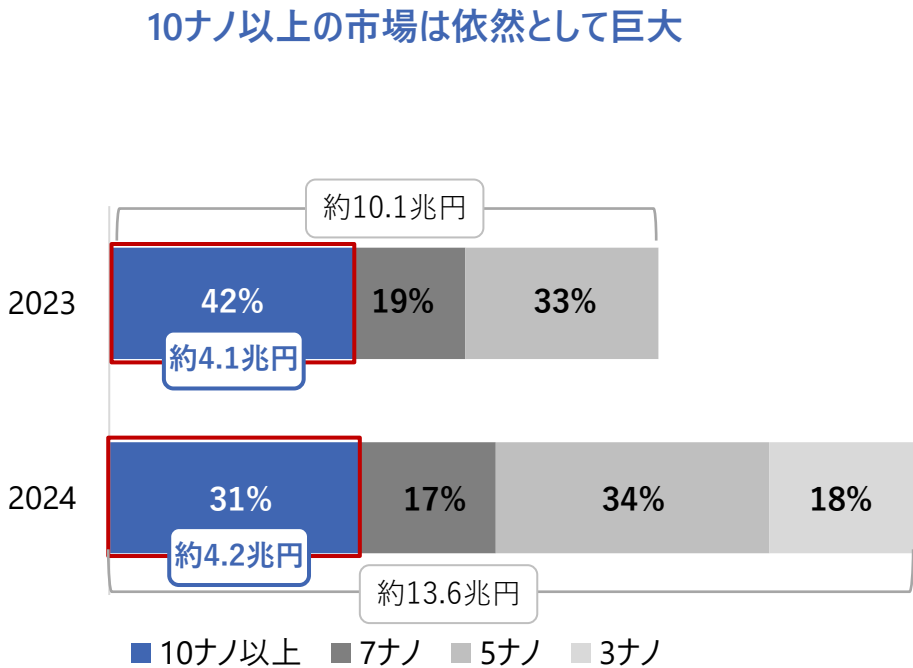
レガシー半導体の旺盛な需要
半導体不足により200mm工場の生産能力が急成長へ、先端企業でもレガシー半導体は主力

200mmウエハーファブ数と生産能力推移



出所：SEMI 2024年9月25日発行、
「世界の200mm半導体前工程ファブにおける生産能力の推移」

TSMCのプロセス別売上構成



2023年：1NTD=4.68円、2024年：1NTD=4.73円
の為替レートにて日本円の売上高を算出
2023年：売上高：約2兆1,000億NTD
2024年：売上高：約2兆8,943億NTD

出所：TSMC 開示資料より当社作成2023年、2024年通期実績

世界市場における旧型半導体製造装置の重要性

「最先端装置」だけでなく、多様な用途に適応する「旧型装置」の需要も高い

- 最先端工場への投資が活発である一方、旧型半導体に関する需要も依然として高く、

旧型半導体製造装置の保守は、最先端半導体開発と同様に重要なテーマである

	市場の現状	投資動向
最先端	生成AI関連の需要旺盛等を背景に、データセンターやスマートフォン等、高性能な最先端半導体の需要は極めて高い状況	国内では官民協力により、TSMC関連投資や、微細化技術の開発など、数兆円規模の投資が進展 国外においても、米国や韓国をはじめ、覇権をめぐる国策としての大規模な投資が活発化
旧型	IoT製品や自動車関連などを中心に、旧型半導体が用いられるパワー半導体やセンサー等の需要は高まる一方、低～中程度の性能の半導体の需要も旺盛 これらを担う <u>20年以上前に投資された半導体製造装置も現役で稼働</u> している状態であり、国内で稼働している半導体工場の <u>8割以上がウエハサイズ200mm以下のレガシー工場</u> である	旧型半導体製造装置は現在も重要性が高く、例えばインドがレガシー工場を中心として包括的に支援するISMを国策として発足 <u>装置の保守</u> （EOL部品の調達、修理、中古装置の購入や立上・改善など）に対しての <u>グローバルな投資が進展</u>

< 200mm / 300mmウエハサイズ工場について >

半導体チップを製造する材料であるウエハの直径サイズを意味しております

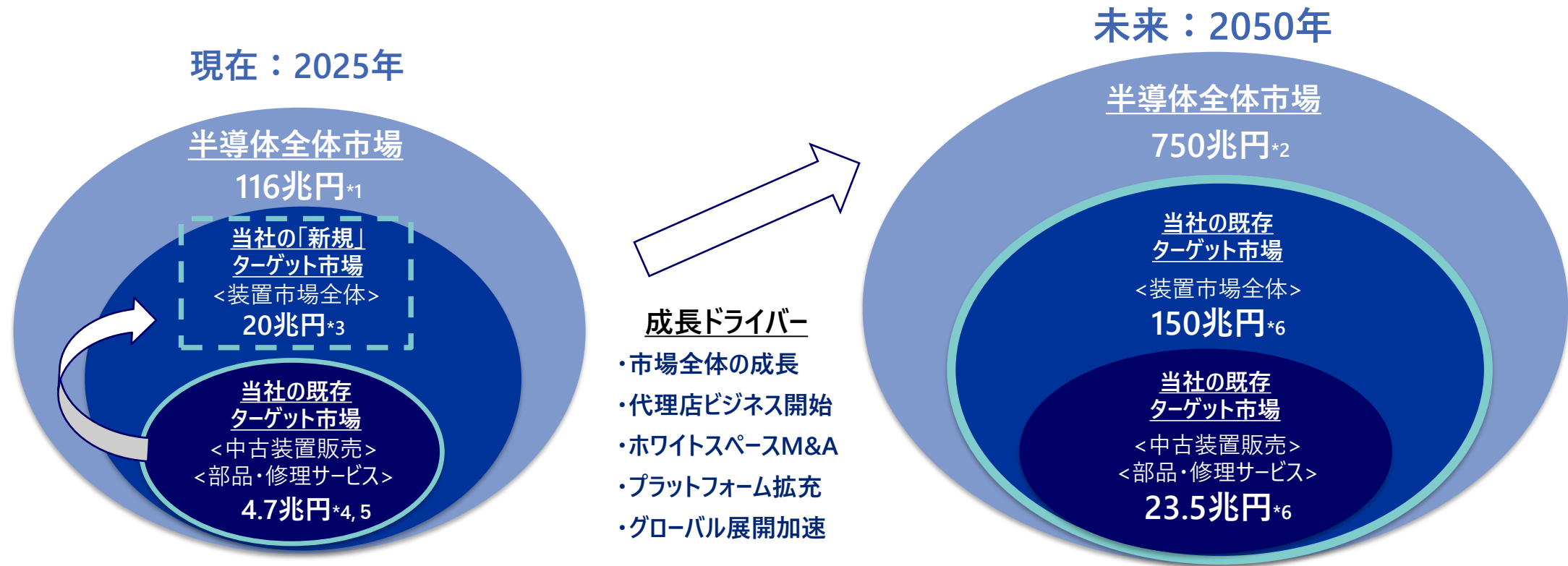
200mmウエハは、過去に広く使われてきた標準的なサイズですが、現在では生産効率の高いより大きな300mmのウエハが主流になっております

200mmウエハを使っている工場は、古い技術を使っていることが多く、レガシー工場と呼ばれることがあります

ターゲット市場

事業領域の拡大とM&Aにより、ターゲットを20兆円規模の「装置市場全体」へ拡大する

- 既存事業のターゲット市場は、半導体市場のうち、中古半導体装置市場、部品・修理サービス市場である
- 半導体装置代理店ビジネスの開始や、今後見込まれるM&A戦略により、
中長期的には半導体製造装置市場全体をターゲット市場と見据える



^{*1} 出所：(一社)WSTS日本協議会「WSTS 2025年秋季半導体市場予測について」

^{*3} 出所：SEMI「世界半導体製造装置の2025年末市場予測発表」を元に試算

^{*6} 2050年は、半導体市場全体の成長率と同水準で推移するものと仮定し算出

^{*2} 出所：東京エレクトロン㈱ コーポレートサイト「The Future of the Semiconductor Industry and its People」

^{*4} 出所：The Business Research Company「中古半導体装置の世界市場レポート 2025年」 ^{*5} 半導体製造装置市場の20%と仮定

※150円/USDにて日本円換算

AGENDA

1. 事業概要

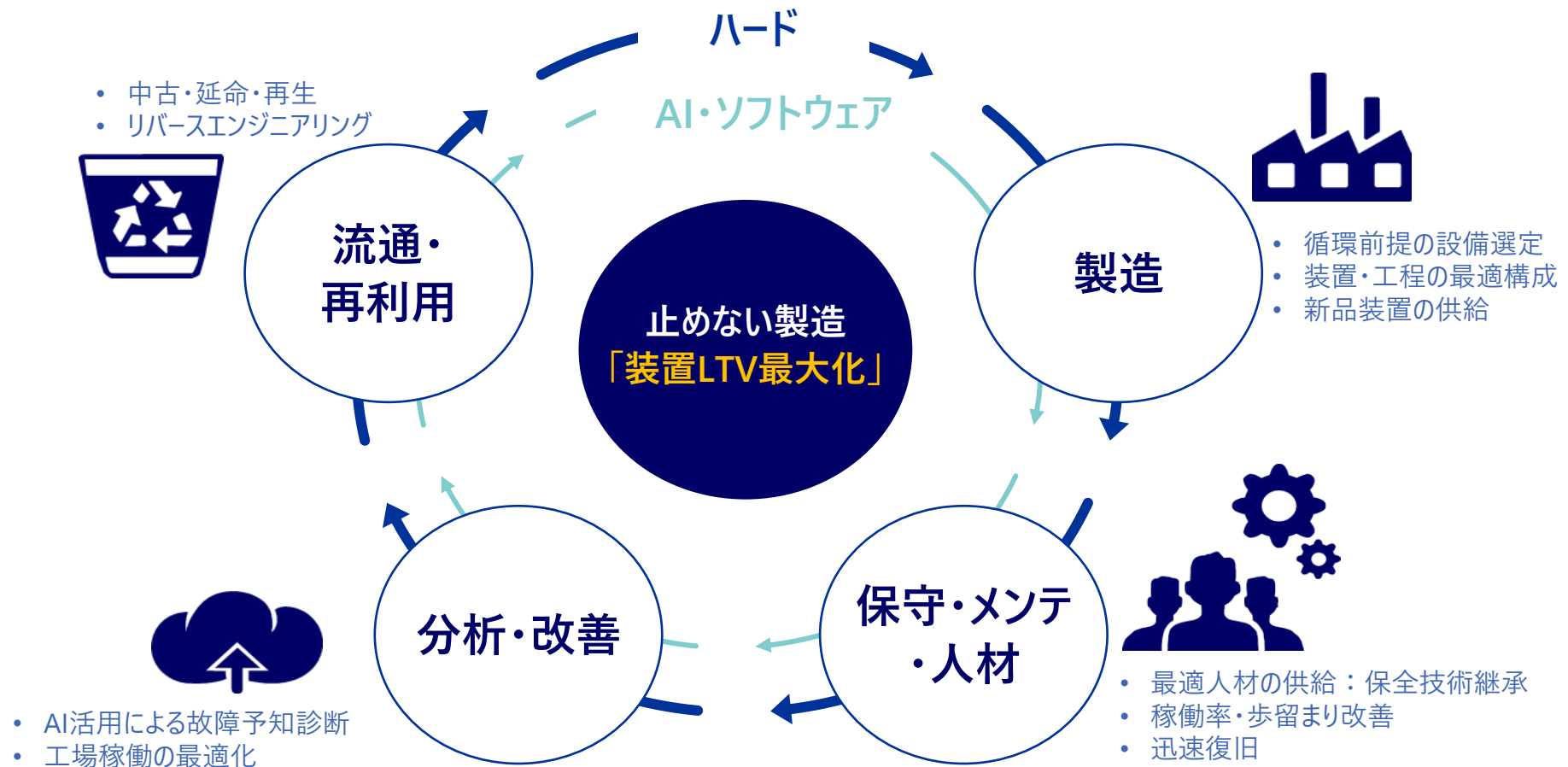
2. 市場環境

3. 成長戦略

4. 中期経営計画

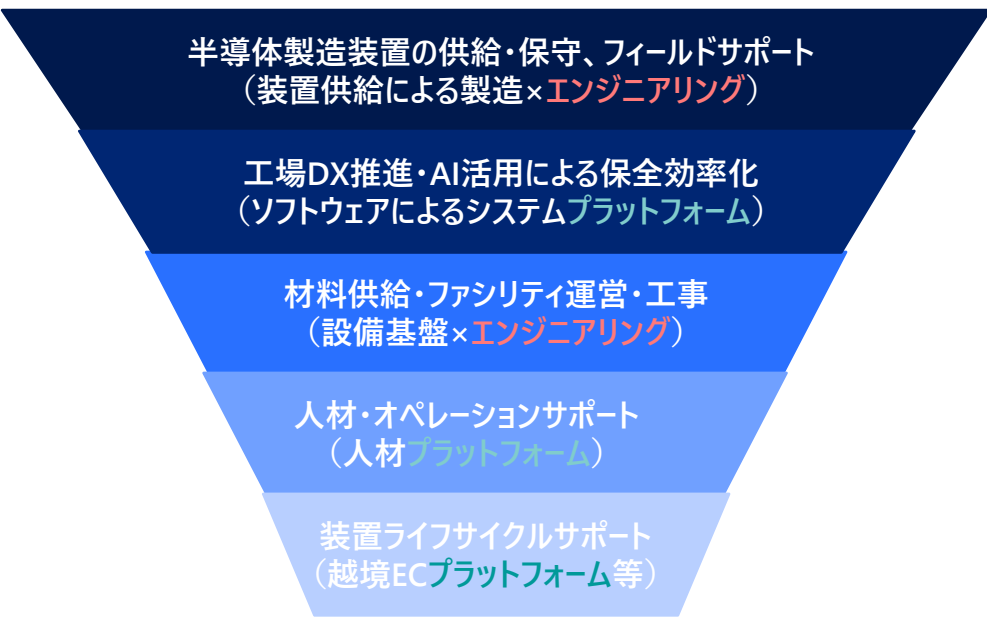
- 資源枯渇、紛争・分断など不確定要素が高まる社会では、「止めない製造」を実現するための循環設計が重要視
- 「故障予知により稼働を止めない」、「稼働率・歩留まり・人材定着まで含めた価値提供」、新品前提から「循環型」へ

循環設計



TMHは、アフターサービスを担う装置ライフサイクルサポートから、仕組みとシステムによるプラットフォームを通じて半導体製造を統合的に支援する「半導体製造インテグレーター」へと進化する

Vision1000



半導体製造インテグレーターへ 工場の多様な課題をエンジニアリング×プラットフォームにより解決	
製造	サービス：工場全体の運営受託、生産性改善・コスト最適化の請負契約 収益モデル：工場運営全体の包括契約、高付加価値モデル
DX・AI予知保全	サービス：DX推進/AI活用により、半導体工場のレガシーシステムの改善・刷新 収益モデル：SaaSモデル、ソフトウェア利益率による高収益化
材料供給 ファシリティ管理 工事	サービス：薬液・ガス供給の安定運用、純水・空調・廃棄処理など工場インフラ管理、工事 収益モデル：ストック型収益＋高収益率
人材・ オペレーションサポート	サービス：人材プラットフォームサービス、エンジニア教育・研修プログラム 収益モデル：継続契約化（準ストック型）
装置ライフサイクル サポート	サービス：越境ECを活用した部品販売・修理サービス、エンジニアリングを活かした装置販売、その他付帯エンジニアリングサービス 収益モデル：単発取引あり、一部準ストック型

ホワイトスペースを埋めていくことが、半導体工場の稼働継続に必要な要件を充足
「止めない製造」の実現へ

オーガニック成長を加速させるとともに、インオーガニック成長への施策に取り組み、Vision1000の達成へ



*売上高については流通総額の情報として記載しております

最先端プロセス装置と環境対策装置の2領域において、国内の大手デバイスメーカー複数社への提案が進行中

① 最先端プロセス装置

- 海外大手装置メーカーとの国内独占代理店契約を締結済み
- 主要ターゲットは日本国内の先端メモリメーカー
- スポット取引である中古装置と異なり、継続的な販売と販売後の保守/メンテナンスによる継続的な収益を見込む

② 環境対策装置 — 新棟建設・装置増設に連動する需要構造



CVD・ALD・エッチングは温室効果ガス・有毒ガスを大量に使用することから、環境対策設備なしには工場を稼働できないため、プロセス装置1台の増設ごとに環境対策装置需要が発生

- 海外大手装置メーカーとの国内独占代理店契約を締結済み

プロセス装置提案の進捗状況

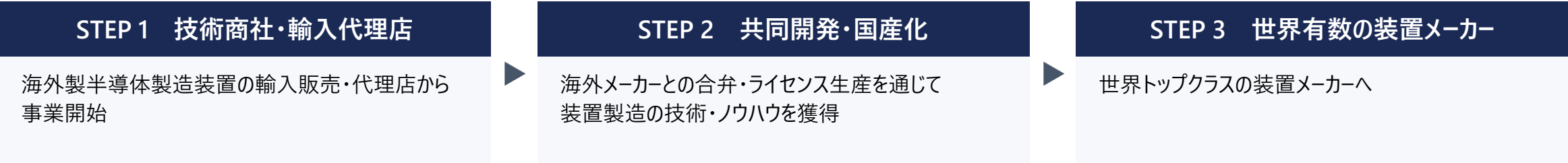


※ 受注時期・金額は顧客の投資計画および入札・選定プロセスに依存

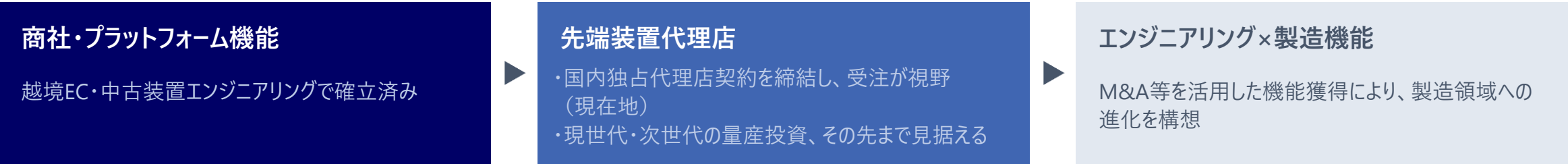
装置代理店は「技術商社→装置メーカー」への進化の第一歩

装置代理店は単なる販売機能ではなく、技術獲得を通じて事業構造を進化させる戦略的布石として計画

【参考】半導体製造装置メーカーA社の成長経路



当社の現在地と進化の方向性

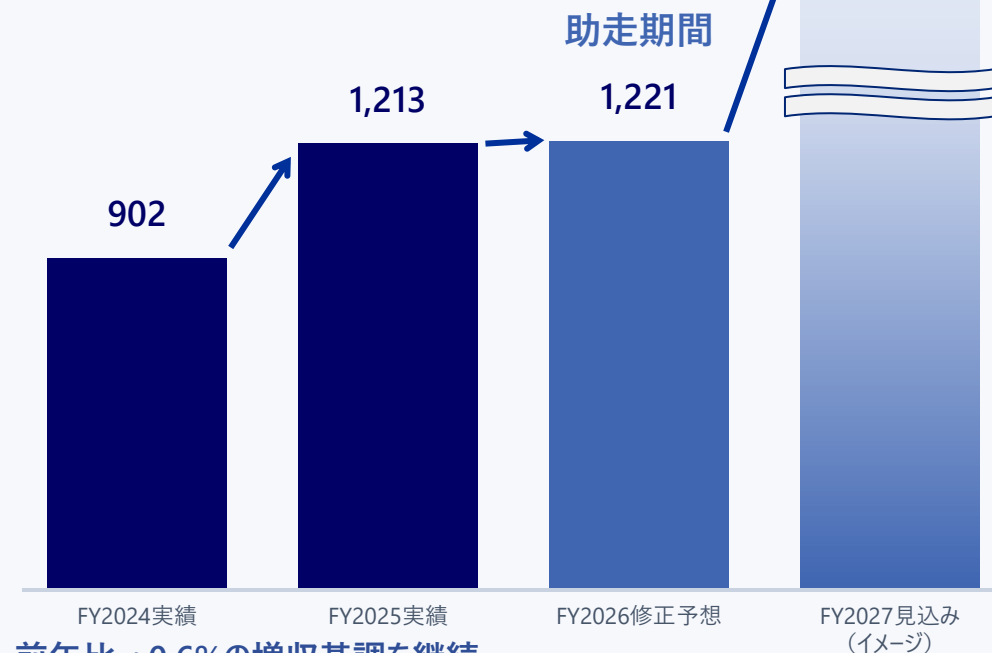


AI時代に最も評価される「半導体 × ものづくり」の中核プレイヤーへ

越境EC: 部品販売・修理サービスは増収継続、FY2027に再加速へ

越境EC等を活用した部品販売・修理サービスは、サプライヤー基盤の強化により再加速を計画

部品販売・修理サービス 売上高の推移（百万円）



前年比 +0.6%の増収基調を継続

LAYLA関連売上はFY2022以降CAGR +34.9%で拡大

FY2027 再加速ドライバー：サプライヤー基盤の強化

- 米国大手半導体材料メーカーとの国内販売代理店契約の締結に向け推進中
- 同社の材料・消耗材は半導体の生産量に連動する反復購買型で、ストック型収益の拡大に直結

世界有数の材料メーカーとの連携により、
調達力・取扱領域を拡大し、EC事業の再加速を企図

ホワイトスペースの開拓に注力し、既存事業とのシナジーを最大化

- M&Aにより「ホワイトスペース」開拓のスピードを高め、**半導体工場の“半導体製造インテグレーター”へ進化**する
- 既に自社内に専門チームを立ち上げており、公開情報のみならず、自社プラットフォームで入手した独自情報に基づき検討を推進中

M&A戦略の位置づけ

		プロダクト・サービス	
		既存	新規
市場	既存	市場浸透戦略 既存製品×既存市場	新製品開発戦略 新規製品×既存市場
	新規	新市場開拓戦略 既存製品×新規市場	多角化戦略 新規製品×新規市場

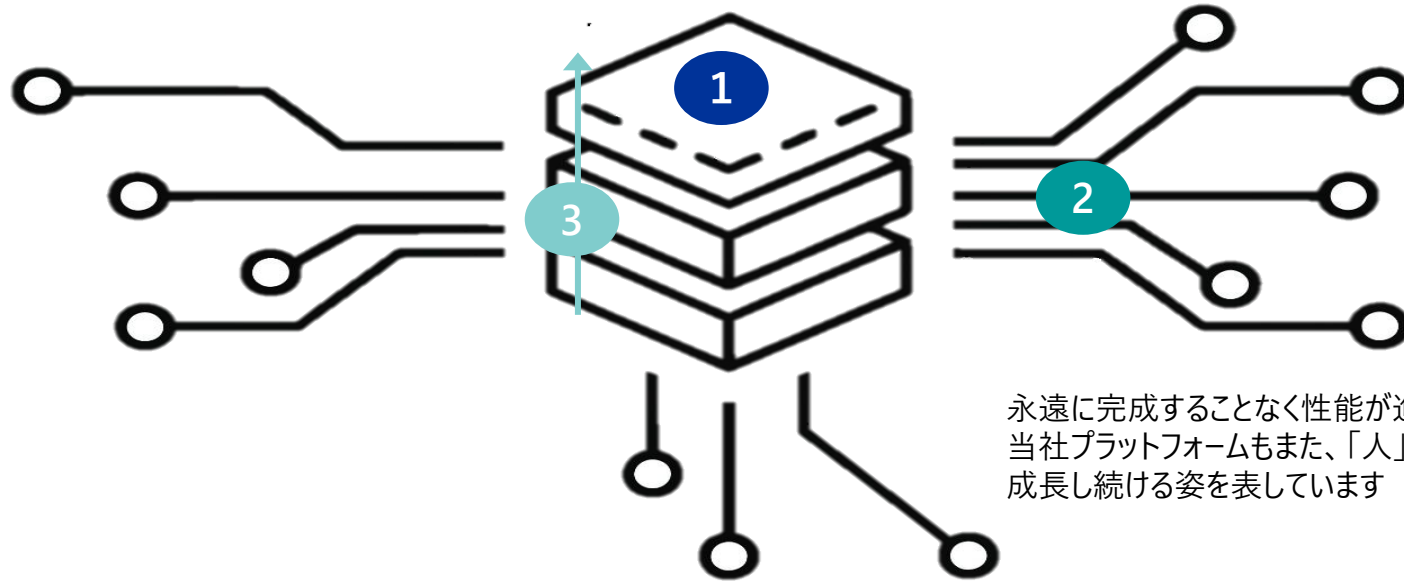
対象候補の例

M&Aの目的		候補領域	優先度
1	事業統合 <ホワイトスペースの開拓>	・材料供給系 ・ファシリティ系 ・工事系 ・人材系（教育・研修） ・ソフトウェア系（Sier） ・メーカー機能（部品・エンジニアリング） ...etc	高
2	機能統合	部品供給・メンテナンス、 装置エンジニアリング領域	中
3	市場拡大	物流領域等	低

LAYLA-ECの「モノ」に加え、人・情報を軸としたプラットフォームを拡張し、半導体産業の成長を後押し

プラットフォームの未来像

半導体製造の「人」、「モノ」、「情報」のプラットフォーム化が新たな付加価値を生み出す



①LAYLA-EC「モノ」
安定収益基盤の拡張

半導体が“動き続けるための物理層”：
(前提条件)

商品点数の拡充、顧客深耕により、継続的な売上拡大・利益の積層を実現することで当社利益の土台へと成長

②LAYLA-HR「人」
成長エンジンの多層化 SaaS型領域へ

半導体の配線、回路のように
価値を生む“機能”そのもの

技術世代の変化に伴う人材需要を捉え、高度・専門領域へと展開することで付加価値と収益機会を拡大

③SEMICON.TODAY「情報」
非連続成長の創出

各レイヤーがどう接続されるべきかを
共有する設計思想・情報層

情報の積層と拡張により、新たな事業機会・連携・価値創出を生み出す成長基盤へと進化

安定収益基盤の拡張に加え、新たな収益ポートフォリオへの展開や既存事業とのシナジーを見込む

①LAYLA-EC「モノ」
安定収益基盤の拡張

半導体工場の調達インフラの一つへ

- 商品ラインナップの拡充・顧客深耕により、修理・部品調達の半導体工場のワンストップ調達基盤へ

類似高付加価値装置産業への展開

- 半導体工場で培ったECプラットフォームのノウハウを活かし、医療機器など高信頼性が求められる装置産業へ横展開

②LAYLA-HR「人」
成長エンジンの多層化 SaaS型領域へ

当社に適合する有能な人材は
オーガニックグロスへ

- 競合激しい人材獲得を独自プラットフォームで確保
- 中長期戦略を見据えたバックキャスト採用

BtoB SaaS型プラットフォームとして専門性で
差別化された収益

- 人材需給のひっ迫が続く中で、企業・エージェント双方が人材探索プラットフォームとして利用拡大、安定的かつスケラブルな収益源へ

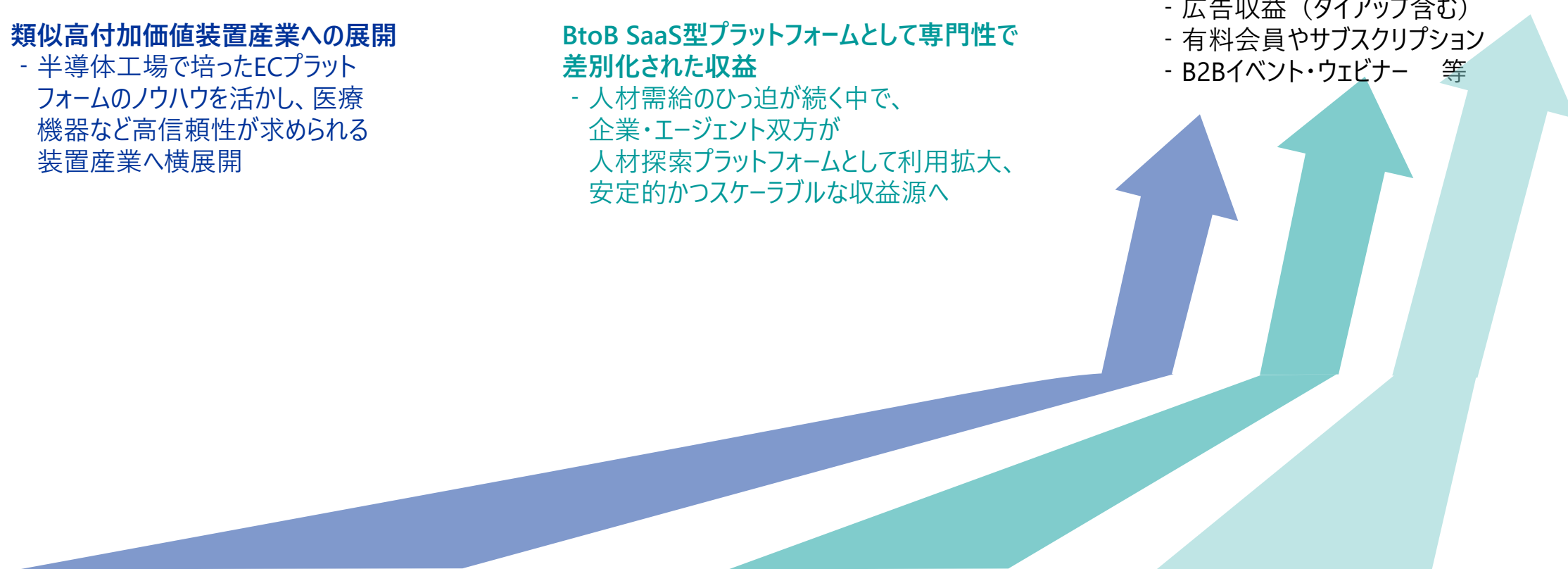
③SEMICON.TODAY「情報」
非連続成長の創出

CXO層を起点とした事業シナジー

- トップレベルでの事業提携
- 実務者レベルでの既存事業との連携

B2B専門メディアとしての自立収益

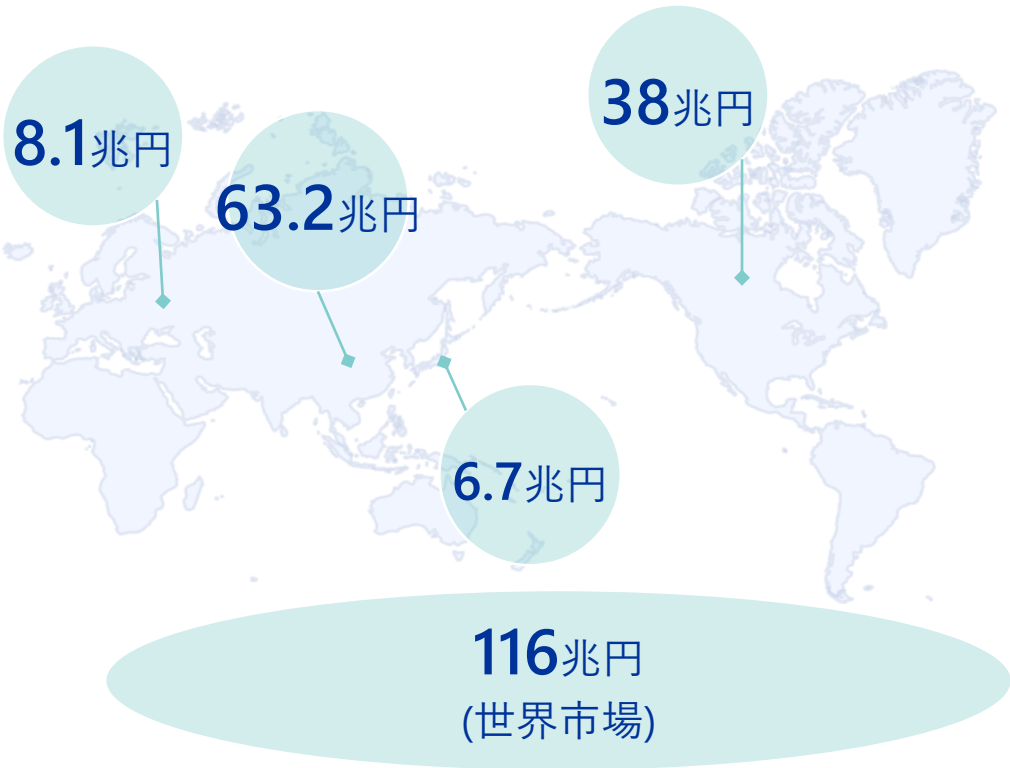
- 広告収益（タイアップ含む）
- 有料会員やサブスクリプション
- B2Bイベント・ウェビナー 等



装置延命のトータルソリューションノウハウを活かし、海外展開し売上拡大を図る

国内のトータルソリューションにより培ったノウハウを、海外に展開
2025年の海外進出を皮切りに、世界規模での躍進を目指す

2025年の半導体市場



(出所) World Semiconductor Trade Statistics／世界半導体市場統計

海外展開ポテンシャル

韓国	DRAMやNANDフラッシュなどの特定の製品に特化しているため最先端装置が中心。装置売却ニーズは恒常的に発生
中国	中国は半導体の技術進化に取り組んでおり、最先端技術の追求と共に旧世代の技術や装置を用いる工場への投資継続
台湾	世界的な半導体製造のリーダーとしての地位を維持するための競争が激しく、旧世代の工場も効率的な運用が必要
インド	インドの半導体市場は政府と民間企業の協力による投資が進行中で、大きな成長を遂げている。投資する技術レベルからも中古装置購入やメンテナンス需要の拡大が見込まれる
米国	多くの米国企業が製造をアジアにアウトソーシングしているため、国内の製造能力や技術力の維持・強化が課題
欧州	他の地域に比べて最先端の半導体技術の研究開発が遅れており、旧世代の工場に依存する部分が多い

AGENDA

1. 事業概要

2. 市場環境

3. 成長戦略

4. 中期経営計画

中期経営計画
FY2028では営業利益17.6億円への飛躍的な拡大を目指す

- 調達機会の一時的な減少による装置販売の減収と、代理店ビジネス向け採用費用の先行計上等により、FY2026は減収・減益を見込む
- 中期的には新規事業である装置代理店ビジネスの拡大およびホワイトスペースM&A、これらのシナジー効果により
営業利益17.6億円を見込む

CAGR (単位：百万円)

	FY2025 実績	FY2026 予想	FY2027 計画	FY2028 計画	FY2028 -FY2025比 (増減率)
売上高	8,628	3,179	10,336	12,805	+4,176 (+48.4%)
売上高（流通総額）*	8,628	3,179	14,153	18,291	+9,662 (+112.0%)
売上総利益	970	443	2,967	3,457	+2,486 (+256.3%)
（売上総利益率）	11.2%	14.0%	28.7%	27.0%	+15.8pt
営業利益	355	▲276	1,421	1,767	+1,411 (+396.9%)
（営業利益率）	4.1%	－%	13.8%	13.8%	+9.7pt

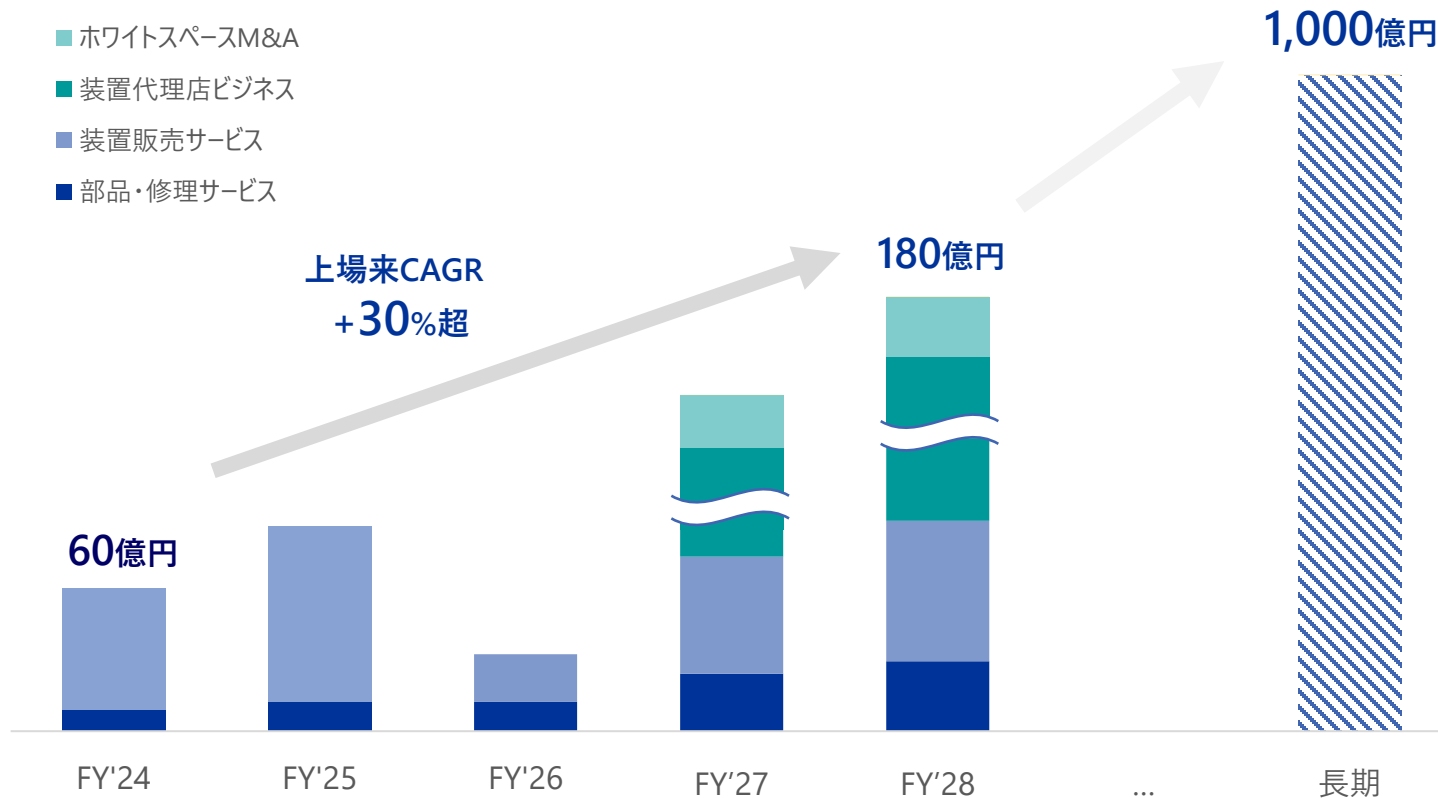
* 装置代理店ビジネスのうち、財務諸表上の売上高と売上原価が純額計上となるものを、総額計上とした場合の数値

中長期成長イメージ（売上高）

代理店とM&Aでポートフォリオを広げ、中長期で売上高1,000億円への成長を目指す

- 中長期的には**代理店ビジネス**、**ホワイトスペースM&A**を成長ドライバーに加え、更なる成長を図る
- 半導体装置の代理店は単なる仲介業者に留まらず、各装置メーカーの国内におけるいわば“顔”の役割
当社のプラットフォーム力・エンジニアリング力の発揮、強化により既存事業とのシナジーを創出

売上高（流通総額）推移



ホワイトスペースM&A

当期より取り組みを始めたM&Aに関して、本中計期間中の実行に向けて進捗。中長期のトップラインを押し上げ

代理店ビジネス

韓国装置メーカーと、国内取扱における独占代理店契約締結
既にFY2027の売上につながる具体的な引き合いがあり、
1台3億円以上×年間数台～数十台の受注確度高

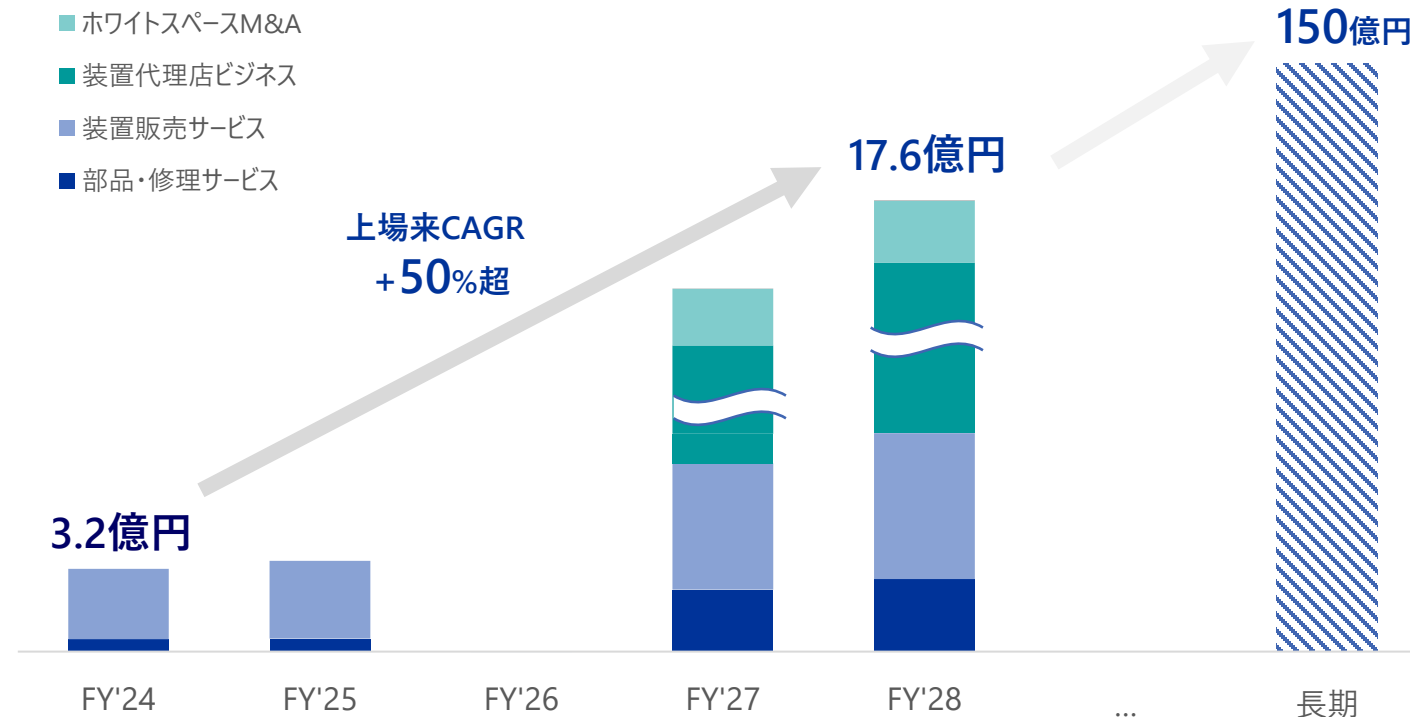
中長期成長イメージ（営業利益）

高利益事業の成長と収益構造の進化により、営業利益150億円の達成を目指す

- 装置代理店ビジネス、ホワイトスペースM&Aを成長ドライバーに加え、更なる成長を図る
- 利益効率の高い装置代理店ビジネスの成長、増収に伴う固定費率の縮小により

営業利益は上場来CAGR+50%超へ

営業利益推移



装置代理店ビジネスの 高い利益効率

既存の装置販売事業と比して高い利益率の確保が可能となり、さらなる利益拡大を見込む

増収レバレッジ効果

大幅な増収・固定費率の縮小により 利益拡大

本資料の取扱いについて

本資料は、株式会社TMH（以下「当社」といいます。）の企業情報等のご案内のみを目的として当社が作成したものであり、当社の有価証券の投資勧誘等を目的としたものではありません。

本資料に記載されている情報は、現時点の経済、規制、市場等の状況を前提としています。

本資料には、将来の予想に関する記述が含まれています。これら将来の予想に関する記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。

このような将来予測に関する記述には、既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報および第三者の作成に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、そのデータ・指標等の正確性・適切性等について、当社は独自の検証は行っておらず、何らその責任を負うことはできません。